

Seco Tools GmbH
Kontakt: Gudrun Winkler
Tel.: +49 (0)211 2401-381
gudrun.a.winkler@secotools.com
www.secotools.com

Pressemitteilung

Vielseitiges Kopierfrässystem steigert Schruppleistung und Effizienz

Erkrath, 16. Juni 2025 – Das jetzt in optimierter Ausführung erhältliche Kopierfrässystem Rundplatte 20 von Seco sorgt für hohe Leistung und Effizienz in einer Vielzahl mittelschwerer bis schwerer Fräsanwendungen. Die Kopierfräser und Wendeschneidplatten sind für zahlreiche Werkstoffe ausgelegt und mit früheren Generationen der Werkzeugreihe kompatibel. Die zusätzliche Verwendung von Hartmetall-Auflageplatten und Kassetten ermöglicht, die Standzeit zu verlängern und Werkzeugkosten zu minimieren.

Für eine wirtschaftliche Bearbeitung benötigen Unternehmen flexible Lösungen, mit denen sie verschiedenste Kopierfräsanwendungen umsetzen, ihre Schneidkanten effizient nutzen und die Produktivität steigern können. Weitere wichtige Faktoren sind geringe Werkzeugkosten und die Vermeidung von Plattensitzschäden. Die neue Generation des Kopierfrässystems Rundplatte 20 von Seco erfüllt alle diese Anforderungen und überzeugt mit hoher Vielseitigkeit und Leistung.

Hochproduktive Fertigung

Rundplatte 20 eignet sich für eine breite Palette von Kopierfräsanwendungen sowie auch zum Plan-, Nut-, Tauch- und Rampfräsen. Die große Auswahl an Wendeschneidplattensorten ermöglicht eine effiziente, leistungsstarke Bearbeitung von Stahl, Rostfrei, Gusseisen, hitzebeständigen Superlegierungen und gehärteten Werkstoffen. Die Wendeschneidplatten mit einem Durchmesser von 20 mm steigern das Zeitspanvolumen und erlauben, kosteneffizient R10-mm-Radien zu realisieren. Die optimale Nutzung der Schneidkanten erhöht zusätzlich die Produktivität.

Längere Lebensdauer, geringere Werkzeugkosten

Die Kopierfräser sind optional mit Hartmetall-Auflageplatten und Kassetten ausgestattet, die Anwender bei einer Beschädigung des Plattensitzes einfach austauschen können. Der Fräskörper muss nicht gewechselt werden. Dies reduziert Stillstandzeiten und Werkzeugkosten. Benoît Patriarca, Produktmanager bei Seco, ergänzt: „Das verbesserte Kopierfrässystem Rundplatte 20 ermöglicht, die Wendeschneidplatten mit vier, sechs oder acht Schneiden zu verwenden. So können Anwender den Verbrauch an die jeweils erforderliche Schnitttiefe anpassen. Außerdem lassen sich sowohl die Wendeschneidplatten der alten Rundplatte 20 Generation in den neuen Fräskörpern einsetzen als auch die neuen

Wendeschneidplatten in den alten Fräsern, sofern diese auf vier oder acht Positionen indexiert sind.“

Große Auswahl an Fräsern und Wendeplatten

Rundplatte 20 umfasst 16 Fräskörper und 30 Wendeschneidplattentypen. Darüber hinaus sind vier Hartmetall-Auflageplatten- und drei Kassettenoptionen erhältlich.

Weitere Informationen zum Fräskörpersystem Rundplatte 20 erhalten Sie unter www.secotools.com/article/146879.

####

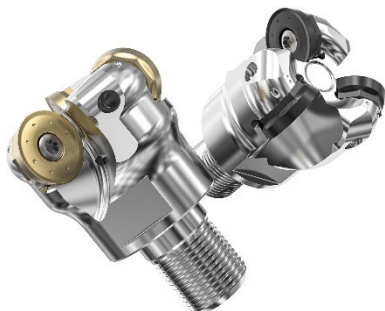
In Fagersta, Schweden, gegründet und in mehr als 75 Ländern vertreten, ist Seco ein weltweit führender Anbieter von Zerspanungslösungen zum Fräsen mit Wendeplattensystemen und Vollhartmetallfräsern, zum Drehen, Bohren, Gewindeschneiden und -drehen sowie für Werkzeug-Systeme. Seit fast 100 Jahren bietet Seco exzellente Lösungen für hochpräzise Bearbeitung und hochqualitative Ergebnisse im gesamten Zerspanungsprozess.

Der Standort von Seco in Deutschland befindet sich in Erkrath bei Düsseldorf. Ein flächendeckendes Netz von hochqualifizierten Mitarbeitern für die technische Beratung und Vertriebspartnern bietet eine kundennahe Betreuung und regionalen Kundenservice vor Ort.

Weitere Informationen zu innovativen Produkten, Service, Zerspanungswissen und -erfahrung von Seco für alle Branchen finden Sie unter www.secotools.com.



Das verbesserte Kopierfrässystem Rundplatte 20 von Seco sorgt für hohe Leistung in zahlreichen Anwendungen und Werkstoffen. © Seco Tools



Die wechselbaren Hartmetall-Auflageplatten und Kassetten des Kopierfrässystems Rundplatte 20 von Seco steigern die Verwendungsdauer und reduzieren Werkzeugkosten. © Seco Tools